

证券代码：600460

证券简称：士兰微

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	电话会议交流
调研时间	2023年10月26日 20:00—21:30
调研机构名称 (排名不分先后)	中邮证券、中信证券、安信证券、长江证券、国信证券、财通证券、天风证券、首创证券、浙商证券、招商证券、民生证券、东北证券、中金公司、国金证券、华泰证券、中泰证券、平安证券、光大证券、国海证券、申万宏源证券、中信建投证券、瑞穗证券、摩根士丹利、海通证券、兴业证券、西南证券、汇丰证券、美银证券、德邦证券、万和证券、天弘基金、华夏基金、博时基金、嘉实基金、景顺长城基金、鹏华基金、长城基金、富安达基金、东方基金、易米基金、鹏扬基金、泰康基金、兴证全球基金、正鑫基金、富达基金、汇丰晋信基金、南方基金、东吴基金、民生加银基金、中欧基金、华安基金、西部利得基金、华商基金、圆信永丰基金、兴业基金、中信保诚基金、新华基金、创金合信基金、北信瑞丰基金、首钢基金、一汽产业基金、湖南省财信产业基金、山东铁路发展基金、中兵投资、银河投资、中移资本、浙银资本、民生通惠资管、信银理财、中国人寿资管、太平资管、大家资管、华泰资管、太平洋保险、中邮人寿、中汇人寿、横琴人寿、建银国际、浦银国际、海通国际、君和资本、淡水泉、高毅投资、高盛资管、瑞银、瑞士信贷、花旗银行、摩根大通、野村国际、三井住友德思资管、大朴投资等 260 余位机构投资者。
公司接待人员	董事会秘书、财务总监陈越先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍：</b> <b>公司 2023 年三季度经营情况介绍</b> 本报告期内（7-9 月），公司加大了模拟电路、IGBT 器件、IPM 智能功率模块、PIM 功率模块、碳化硅功率模块、超结 MOSFET 器件、MCU 电路、化合物芯片和器件等产品在大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场的推广力度，公司总体营收保持了较快的增长势头，实现营业收入 24.24 亿元，较去年同期增长 17.68%，较今年二季度增长 0.58%。 三季度是公司连续第二个季度营收站上 24 亿元人民币台阶，虽然环比只有 0.58%，但这个成绩是在竞争加剧的环境中取得的，实属不易。因为三季度有不少品类的产品价格出现了不同程度的下降。	

2023年1-9月士兰微总体营收较去年同期增长10.49%，这相对今年的半导体市场而言，属于较高的增速。根据国家统计局统计，国内1-9月份集成电路产量同比下降2.5%。

公司产品中，IPM产品继续保持了40%以上的增长，预计全年增速在40%以上；IGBT产品（包括IGBT单管和PIM模块）、超结MOSFET、汽车电子器件、PoE电路、32位MCU电路等增速较快，这些和公司在今年半年报中的描述基本一致。

本报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润为-14,803万元，较去年同期减少32,308万元；公司实现扣除非经常性损益后的净利润为2,145万元，较去年同期减少87.17%。公司业绩出现亏损的主要原因系公司持有的其他非流动金融资产中昱能科技、安路科技股票价格下跌，导致其公允价值变动产生税后净收益-18,241万元。

公司该两笔金融资产，系公司长期股权投资形成，因该两笔金融资产对应的被投资企业上市，我们根据《金融工具会计准则》按照该两笔金融资产期末活跃市场报价（二级市场股价）厘定其公允价值，由于今年股市波动较大，导致公司持有的该两笔金融资产账面缩水较多。我们建议投资者判断公司的价值还是要从公司的主要经营活动出发，不要太在意以上两部分金融资产的价格波动。

总体上，公司三季度经营保持了稳健，资本结构也比较稳健。衡量资本结构可以用资产负债率指标，三季度末公司资产负债率：51.58%；二季度末资产负债率：52.19%。

从扣除非经常性损益后的净利润角度分析，一季度扣非后的净利润：1.13亿元，二季度扣非后的净利润0.49亿元，三季度扣非后的净利润：0.21亿元。三季度扣非后净利润减少主要是研发费用增加。

本报告期内，公司持续加大对模拟电路、功率器件、功率模块、MEMS传感器、碳化硅MOSFET等新产品的研发投入，加快汽车级、工业级电路和器件芯片工艺平台的建设进度，加大汽车级功率模块和新能源功率模块的研发投入，公司研发费用较去年同期增加了21.23%。公司三季度研发费用为2.20亿元，而二季度研发费用为1.80亿元，去年三季度研发费用为1.82亿元。

作为IDM公司，公司具有资产偏重的特征，因此观察公司经营活动还可以用“投资收益——联营企业投资收益”这个指标，这个指标涵盖了公司在厦门两家重要参股企业的经营情况。三季度公司对联营企业投资收益：-0.47亿元；二季度对联营企业投资收益：-0.56亿

元。看上去，三季度这个指标与二季度相比进步不大，但这是在厦门两家公司资产投入持续增加，资产折旧持续增大的情况下取得的，应该说公司对联营企业投资收益有较好改善（这主要通过加强成本控制、加快产品结构调整等措施取得），目前距离彻底改善还需要较长一段时间。

本报告期内，公司子公司士兰集成 5、6 吋芯片生产线产能利用率已回升至 90% 左右，且保持稳定；公司子公司士兰集昕 8 吋芯片生产线保持满负荷生产；公司子公司士兰明芯 LED 芯片生产线产能利用率也接近满产，公司重要参股企业士兰明镓 LED 芯片生产线产能利用率也达到 90% 以上。因加快调整产品结构，公司重要参股企业 12 吋芯片生产线产能利用率下降至 70% 左右，公司减少了低附加值产品的产出，正在加快 IGBT 等高附加值产品的上量，预计 4 季度 12 吋线产能利用率将回升。

本报告期内，由于市场竞争压力加大，公司多个品类的产品价格较去年同期有一定程度的下降；同时在公司加快调整产品结构过程中，也会有部分产能未能充分利用的情况存在，且产能增加也会导致固定成本提高，这些都会在一定程度上造成公司产品综合毛利率的下滑。公司三季度产品综合毛利率为 21.87%，较去年同期减少 5.55 个百分点；较今年二季度减少 0.65 个百分点，随着公司持续推出富有竞争力的产品，持续加大对大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场的推广力度；同时持续改善生产成本，我们预计 4 季度公司产品综合毛利率水平将企稳并逐步改善。

2023 年 1-9 月，公司电路和器件成品的销售收入中，已有接近 70% 的收入来自大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场。公司电路和器件成品的销售收入占公司总收入 70% 以上，这意味着公司产品已经有一半以上进入了大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场以及高门槛市场中的头部客户。今后这个比例还会进一步提高。

当前，在国家政策持续支持，以及下游电动汽车、新能源等行业快速发展、芯片国产替代进程明显加快的大背景下，士兰微电子迎来了较快发展的新阶段。士兰微电子将持续推动满足车规级和工业级要求的器件和电路在各生产线上量，持续推动士兰微整体营收的较快成长和经营效益的提升。